

汽车巨头争相与华为合作背后：智能驾驶技术引领市场风潮

本报记者 陈靖斌 广州报道

最近，华为举办了鸿蒙生态春季沟通会，展示了多项创新研发成果。会上华为推出了鸿蒙智行的首款智慧轿车——智界S7，

并且公布了鸿蒙智行生态的最新成果，华为在万物互联全场景生态方面的布局进一步完善。

据智界项目相关工作人员向《中国经营报》记者透露，这款智界S7作为鸿蒙智行的首款智慧轿

车，首发搭载了华为视觉智驾 HUAWEI ADS 基础版，而高配版本则搭载了 HUAWEI ADS 2.0 高阶智能驾驶系统。

实际上，智能驾驶技术在国内的迭代发展也在推动华为智能

驾驶车型的销量大增。华为常务董事、消费者BG CEO、华为智能汽车解决方案BU董事长余承东在鸿蒙生态春季沟通会上透露，问界M9上市3个月累计大定突破7万辆，月交付能力持续攀升至

2.5万多辆。而问界新M7上市7个月，累计大定突破17.4万辆，他们希望后续月发货量能够尽快提升到2.5万辆。

华为近期赢得了日本汽车巨头的青睐。4月16日，本田中国正

式发布了全新电动品牌“烨”，其中的新车将采用华为 XSCENE 光场屏。此外，还有消息称丰田可能会接入华为智能驾驶系统。记者向华为终端相关负责人进行了核实，但对方表示“不予置评”。

智界S7 引领华为智驾新风向

华为发布智界S7，搭载华为视觉智驾 HUAWEI ADS，引领智能驾驶新风向，日本汽车巨头争相与华为合作赢市场。

在最近举办的华为鸿蒙生态春季沟通会上，华为发布了智界S7，这是首款搭载华为视觉智驾 HUAWEI ADS 的车型。

据智界相关工作人员介绍，智界S7 Pro 版搭载的是 HUAWEI ADS 基础版，该版本不带激光雷达，支持不依赖高精地图的高速NCA功能，以及160多种车位可见即可泊的智能泊车功能，从而实现全国高速轻松开、智能泊车轻松停的目标。而智界S7的高配版本(Max及以上版本)则搭载了 HUAWEI ADS 2.0 高阶智能驾驶系统，具备全国范围的高速自动驾驶功能，并首次引入了泊车代驾VPD功能，以及机械车位泊车辅助功能和循迹倒车功能，为用户带来了更先进的智能驾驶体验和主动安全保障。

在智能驾驶方面，华为高阶智能驾驶城市NCA功能得到了全面升级，使智界S7具备了全国范围内4万多个城乡主干道和支路的智能驾驶能力，成功率达到了99.2%。此外，智界S7还支持多种智能泊车模式，包括泊车代驾、代客泊车和遥控泊车，并且覆盖了超窄车位、机械车位等复杂异形车位。

此外，智驾技术的新进展也推动了华为智能驾驶车型的销量大幅



智界S7

陈靖斌/摄影

增长。

余承东透露，问界M9上市3个月累计大定突破7万辆，月交付能力持续攀升至2.5万多辆。问界新M7上市7个月，累计大定突破17.4万辆，他们希望后续月发货量能够尽快提升到2.5万辆。

近期，华为还受到了日本汽车巨头的青睐。本田中国于4月16日正式发布了全新电动品牌“烨”，并宣布采用华为 XSCENE 光场屏。此外，据悉，丰田也可能会接入华为智能驾驶系统。尽管记者向华为方面求证，但对方表示“不予置评”。

值得注意的是，丰田与华为此前已有合作，主要集中在智能座舱领域。今年3月，广汽丰田全新第9代凯美瑞上市，新车的车机系统由广汽丰田与华为共同打造，搭载高通骁龙8155芯片，提供了更为流畅的操作体验。此外，将于北京国际车展迎来首发并开启大定的一汽丰田旗下国产全新普拉多也传出会引入华为HiCar的消息。

对此，知名战略定位专家詹军

豪告诉记者，丰田等汽车巨头与华为进行智能驾驶合作，既带来了机遇，也带来了挑战。

“与巨头车企的合作将进一步提升华为在智能驾驶领域的知名度和影响力，加速其技术的市场推广和商业化进程。同时，合作也将为华为带来更多的资源和支持，有助于其进一步完善智能驾驶生态系统。然而，挑战也不可忽视。与巨头车企的合作意味着更高的技术要求和更严格的质量标准，华为需要不断提升自身的研发实力和技术水平，以应对激烈的市场竞争。”

传播星球App联合创始人由曦也指出，与丰田等巨头进行智能驾驶合作，对于华为而言既是机遇也是挑战。“机遇在于，这将有助于华为扩大其智能驾驶业务的覆盖范围和影响力，同时也有助于提升华为智能驾驶技术的知名度和口碑。然而，挑战也不可忽视，因为与巨头合作需要面对复杂的合作机制和利益分配问题，同时也需要应对潜在的竞争压力和风险。”

华为智驾助力智能汽车“崛起”

智能汽车产业竞争激烈，华为智驾布局提速，加速推进智能驾驶技术发展，但仍面临人才、研发以及营商环境等挑战。

随着汽车行业智能化的不断推进，智能汽车产业的高度竞争时代已到来。据乘用车市场信息联席会的数据分析显示，中国智能汽车产业的市场渗透率正从40%的高速增长长期转变为80%的市场成熟期。未来，智能技术和量产能力的竞争将主导市场。

华为在汽车领域的布局经历了一系列挑战与合作。

自2019年起，华为大规模进军汽车业务，采取了三种主要合作模式：第一是零部件供应模式，提供包括ARHUD、激光雷达、热管理和电驱等零部件；第二是HI(Huawei Inside)模式，为车厂提供智能座舱、智能驾驶和智能车云等全栈智能汽车解决方案，曾与北汽极狐、广汽埃安等合作；第三是智选车模式(鸿蒙智行)，涉及产品开发和渠道。例如与赛力斯合作的问界、与奇瑞合作的智界以及即将推出的与北汽蓝谷合作的享界系列。

去年11月25日，华为与长安汽车签署了《投资合作备忘录》，计划成立一家新的合资公司，华为将车BU业务的核心技术和资源独立出来，长安汽车出资比例不超过40%。这家新公司将逐步对现有战略合作伙伴车企及有战略价值的车企等进

行股权开放，实现股权多元化。

2月22日，东风公司旗下猛士科技与华为签署了战略合作协议，双方将共享产业资源，建立长期战略合作伙伴关系。

3月15日，广汽传祺与华为正式加入了华为鸿蒙生态，成为首批加入鸿蒙生态的汽车品牌之一。

华为消费者业务执行董事余承东在2024年中国电动汽车百人会论坛上透露，今年前3个月，华为智选车业务已经扭亏为盈，智能汽车解决方案BU业务接近盈亏平衡的边缘。预计从4月开始，有望实现扭亏为盈，呈现良性正向发展。

展望2024年，国信证券在今年3月发布的研报中表示：“2023年鸿蒙智行模式销量以问界为核心支撑，包括M5、M7、M9(2023年末上市)三款车型，全年实现超过9万辆整车销量。另有智界品牌在2023年11月发布S7车型，也贡献了一部分销量。2024年，我们预测鸿蒙智行模式有望实现超过50万辆的销量。”

然而，华为智驾的发展仍面临挑战。

由曦指出，华为智驾仍然面临数据收集和处理、算法优化、安全性和可靠性等问题。他建议，华为应进一步加强与

车企的合作，通过数据共享和算法合作共同推进智能驾驶技术的发展。此外，华为还应增加研发投入，引进和培养更多的人才，以提升在智能驾驶领域的核心竞争力。同时，也需要密切关注法规和标准的变化，以便及时调整和适应相关政策规定。

詹军豪也强调了华为智驾在发展过程中面临的一系列挑战和瓶颈。首先，智驾技术的研发和创新需要大量的资金和人才投入，这对于华为而言是一项巨大的挑战。其次，智驾技术的安全性和可靠性是用户最为关注的焦点，华为必须不断提升技术性能和系统稳定性，以满足用户的需求和期望。此外，智驾技术的普及和推广还需克服一些法律和监管方面的障碍。

对此，詹军豪建议华为可以采取一系列措施应对。首先，加强与其他企业的合作与联盟，共同研发和推广智驾技术，共享资源和经验，提升整体行业水平。其次，增加投入，培养和引进相关领域的专业人才，以提升研发实力和创新能力，保持在技术竞争中的领先地位。此外，积极与政府部门沟通合作，推动相关法律法规的完善和优化，为智驾技术的普及和推广创造更加良好的环境。

冲击“智驾芯片第一股” 黑芝麻智能再度闯关港股IPO

本报记者 夏治斌 石英婧 上海报道

近年来，智能网联汽车发展迅猛，自动驾驶芯片企业也驶入发展快车道，它们也在谋求上市，Black Sesame International Holding Limited(以下简称“黑芝麻智

能”)便是其中一例。

《中国经营报》记者注意到，黑芝麻智能曾在2023年6月30日向港交所递交申请IPO，后因未在6个月内通过聆讯，该公司的上市申请在今年1月初失效。3月22日，黑芝麻智能再次向港交所递

交上市申请，中金公司、华泰国际和建银国际为其联席保荐人。

招股书显示，黑芝麻智能2021年—2023年的收入分别是6050万元、1.65亿元、3.12亿元。与此同时，黑芝麻智能年内亏损金额分别是23.57亿元、27.54亿

元、48.55亿元。

黑芝麻智能此番能否成功冲击“智驾芯片第一股”尚不可知。对于公司营收增长、逐年亏损等问题，4月8日、16日，记者致函黑芝麻智能官网邮箱，截至发稿，尚未有回复。4月12日、15日、16

日，记者也多次致电“Wind金融终端”留有的黑芝麻智能号码，但均无人接听。此外，记者在4月12日致电黑芝麻智能相关人员，该工作人员表示会帮记者询问一下官网邮箱的管理，但此后记者多次致电并发短信至该号

码，均未回复。

不过，中国企业资本联盟副理事长柏文喜告诉记者：“对于自动驾驶企业而言，亏损是一个普遍存在的问题，这主要是由于该行业的研发成本高昂，同时商业化进程相对缓慢。”

拟将募集资金的约80%用于未来五年研发

招股书显示，黑芝麻智能是一家车规级计算SoC及基于SoC的智能汽车解决方案供应商，SoC是一种集成了包括中央处理器、内存、I/O接口及其他关键电子元器件的集成电路。

自2016年成立至今，黑芝麻智能备受资本市场的青睐，其已获得北极光创投、上汽集团、招商局创投、海松资本、腾讯、博原资本、东风汽车集团、小米长江产业基金、蔚来资本、吉利、武岳峰资本、中银投资、国投招商、联想创投等知名VC及产业资本的投资，共计10轮融资。最后一轮融资过后，黑芝麻智能的估值达到22.18亿美元。

黑芝麻智能设计了两个系列的车规级SoC，华山系列高算力SoC及武当系列跨域SoC。根据弗若斯特沙利文资料，按2022年车规级高算力SoC的出货量计，其是全球第三大供应商。黑芝麻智能于2022年开始批量生产华山A1000/A1000L SoC并交付超过2.5万片，截至2023年12月31日，公司旗舰A1000系列SoC的总出货量超过15.2万片。

记者注意到，2023年4月，黑芝麻智能发布了武当系列跨域SoC，根据弗若斯特沙利文的资料，此为行业内首个集成自动驾

驶、智能座舱、车身控制及其他计算域的产品。

据悉，黑芝麻智能的客户群由2021年12月31日的45名增长至2023年12月31日的85名。截至最后实际可行日期，黑芝麻智能已与超过49名汽车OEM及一级供应商合作，如一汽集团、东风集团、上汽集团、合创、亿咖通科技、百度、博世、采埃孚及瑞利等。

数据显示，黑芝麻智能的收入来源于自动驾驶产品及解决方案和智能影像解决方案。其中，自动驾驶产品及解决方案2021年—2023年的收入分别是3426万元、1.42亿元、2.76亿元。智能影像解决方案2021年—2023年的收入分别是2624万元、2316万元、3607万元。

以黑芝麻智能自动驾驶产品及解决方案为例，其在2021年—2023年产生的收入占其总收入的比例分别是56.6%、86.0%及88.5%。对于上述情况，黑芝麻智能方面解释称，2022年的显著增长是由于公司的产品及解决方案的销量增加和自有SoC于2022年底量产。

值得注意的是，黑芝麻智能所处的车规级SoC及解决方案行业竞争十分激烈。根据弗若斯特

沙利文的资料，全球车规级SoC市场预计将由2022年的428亿元增长至2028年的1792亿元，期内复合年增长率为27%。此外，根据同一资料来源，基于SoC的智能道路解决方案的全球市场规模预计于2026年将达到约148亿元，于2030年将进一步达到392亿元。

在柏文喜看来，黑芝麻智能的IPO申请显示了该公司对于自动驾驶芯片市场的长期信心和对资本市场的积极态度。“作为冲刺‘国产自动驾驶芯片第一股’的企业，黑芝麻智能的上市行为可能会为其带来资金的注入，有助于加强其在自动驾驶领域的研发和市场拓展。”

柏文喜称：“考虑到自动驾驶技术的快速发展和市场潜力，以及中国政府对智能汽车行业的支持，黑芝麻智能的IPO可能是其发展史上的一个重要里程碑。但投资者可能会对其持续的亏损和未来盈利能力保持关注，这将是公司需要在IPO过程中重点解释和解决的问题。”

据悉，黑芝麻智能此次IPO拟将募集资金的约80%用于在未来五年的研发；约10%将用于提高商业化能力，约10%将用于营运资金及一般公司用途，尤其是采购SoC量产的存货。

三年累计亏损近百亿盈利遇困

从市场上来看，虽然黑芝麻智能已经有着不错的表现，但仍难逃亏损的现状。招股书显示，2021年—2023年，黑芝麻智能年内亏损金额分别是23.57亿元、27.54亿元、48.55亿元。

对于公司亏损的原因，黑芝麻智能给出的理由之一是公司持续投资于研发。相关数据显示，2021年—2023年，黑芝麻智能的研发开支分别为5.95亿元、7.64亿元和13.63亿元。

记者注意到，对于企业的研发开支，黑芝麻智能在招股书中解释道：“我们经营所在行业面临快速的技术变革且在技术创新方面不断快速演变。我们需要在研发方面投入大量资源(包括财务资源)以取得技术进步，从而扩展我们的产品组合及服务，使我们的产品和解决方案在市场上具有创新性和竞争力。因此，我们日后可能继续产生大量研发开支。”

对于企业的市场表现，柏文喜称：“黑芝麻智能的营收增长表明公司在市场拓展方面取得了一定的成效，但亏损的扩大也反映了其在研发、市场推广和产品创新等方面的大量投入。这种亏损状态在短期内可能会持续，直到公司能够实现规模经济和市场占有率的提升。自动驾驶企业需要

通过持续的技术创新，成本控制有效的市场策略来实现长期的生存和发展。”

此外，黑芝麻智能的毛利率也在逐年下降。2021年—2023年，公司的毛利率分别为36.1%、29.4%及24.7%。“毛利率由2021年至2022年有所下降乃由于自动驾驶产品及解决方案的收入贡献增加，当中涉及更多硬件部件，一般意味着毛利率相对较低。”黑芝麻智能方面表示。

黑芝麻智能采用代工模式。在招股书中，黑芝麻智能方面表示：“我们目前依赖台积电制造我们的所有SoC。由于SoC复杂的专有性质，任何从台积电向新制造商的过渡，涉及制造我们SoC的任何台积电设施发生灾难或其他业务中断，引入新设施均会耗费大量时间方可完成，且可能导致我们的存货不足，并对我们的业务、经营业绩及财务状况造成不利影响。此外，我们易受台积电可能无法满足对我们SoC的需求或完全停止运营的风险影响。再者，我们亦易受台积电可能因全球半导体短缺而无法满足需求成本的风险影响。”

对于代工模式的优劣势，柏文喜告诉记者，代工模式对于自动驾驶芯片制造商来说，有其明

显的优势和潜在的风险。“优势在于，企业可以利用台积电等专业化工厂的生产能力和技术经验，快速将产品设计转化为实际产品，缩短产品上市时间，降低自身的生产成本和固定资产投资。此外，代工模式还允许企业专注于核心技术和市场开发，提高运营效率。”

柏文喜补充道：“然而，代工模式也存在一些弊端，如对供应商的依赖度较高，可能会影响产品的质量和交付时间。此外，代工成本的波动也可能对企业的毛利率产生影响。因此，企业在选择代工模式时需要权衡这些利弊，确保供应链的稳定性和产品质量的可靠性。”

台积电位于中国台湾，黑芝麻智能也在招股书中提及，公司获得SoC充足供应的能力可能会受到台湾自然灾害(包括地震、干旱、台风)以及地缘政治挑战等事件的不利影响。

据中国地震台网正式测定，4月3日7时58分，中国台湾花莲县海域(北纬23.81度，东经121.74度)发生7.3级地震，震源深度12千米。此次地震是否对台积电给黑芝麻智能的SoC制造带来影响，记者也在采访函中提及，但同样未获得回复。